

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

隆扬电子（昆山）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	个人投资者 何明 华创证券 姚德昌 永赢基金 郑奇波 (以上排名不分先后)
时间	2026年3月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 傅青炫 董事会秘书 金卫勤 董事长助理 仲汉尧
主要内容介绍	第一部分：公司介绍 上市公司董事长介绍了公司基本情况、核心业务、发展战略等。公司主要产品为电磁屏蔽材料及部分绝缘材料、散热材料,产品主要应用于3C消费电子行业及新能源汽车行业。同时,公司正在积极推进铜箔材料的验证的进程,积极向铜箔材料布局。2025年分别完成了常州威斯双联及苏州德佑新材的两笔并购项目,进一步增强公司材料自研体系的核心竞争力,实现优势互补与资源协同。 第二部分：上市公司解答提问,主要如下: 董事长同与会人员进行了问答交流,本次交流主要内容如下:

	<p>Q1、公司发展战略？</p> <p>公司制定的发展战略是：稳定现有消费电子、汽车电子市场客户，通过（2个）并购项目进行外延式发展，同时公司开发HVLP5高频铜箔等产品开拓未来第二增长曲线。</p> <p>Q2、公司的铜箔产品，目前和客户的验证情况如何？推进如何了？</p> <p>公司HVLP5铜箔目前在配合客户交付部分样品订单，尚未有批量化订单；产品尚在验证之中。</p> <p>Q3、铜箔产品和竞争对手的差异主要在哪里？</p> <p>公司铜箔产品和竞争对手的差异主要是选择不同的工艺路线。</p> <p>Q4、公司的HVLP5铜箔有哪些优势？</p> <p>因本公司采用的工艺路线选择较传统铜箔厂的工艺路线选择不同，磁控溅射技术在做薄和做平坦的方面有较明显的优势。所以铜箔产品面对高频高速信号传输所需的低表面粗糙度的要求下，公司产品可体现相应的竞争优势。公司目前暂无参与hvlp1-4代产品的生产和制作。</p> <p>Q5、公司可剥铜产品的开发进展？</p> <p>公司可剥铜目前还在改进完善中，以使产品更好满足客户要求。</p>
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。